

镀锡铜过流片-Ccu 系列

Tinned Copper Overcurrent Plate - Ccu Series



业展电子
YEZHAN ELECTRONICS

特征 Features

过电流能力强50A - 600A	Strong current load capacity 50A-600A
铜材散热能力强	Excellent thermal conductivity
可焊性好	Excellent Solderability
可编带包装	Taping packaging available
符合ROHS要求	RoHS compliant
特殊规格可以订做	Customizable



应用范围 Applications

散热	Heat Dissipation
导流	Diversion current
低电感电路	Low inductance
大电流脉冲电路	High current pulse circuit

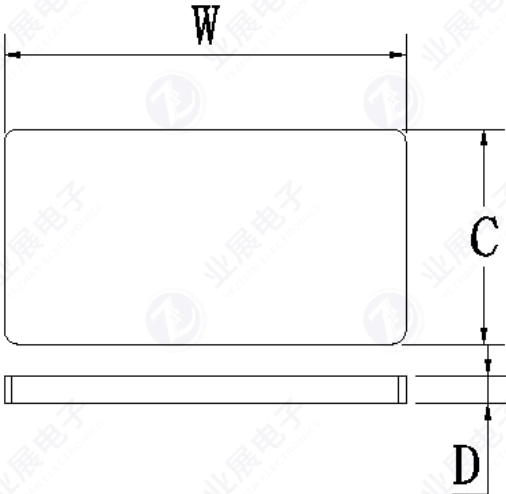
标准尺寸规格 Standard Size

Type	W/mm	C/mm	D/mm
Ccu	120	20	2
	37	16	1.5
	27	5	1
	18	4	1
	16	10	1
	10	4	1
	6.3	3.3	1
	3.2	1.3	0.2

订购信息 Ordering Information

Ccu	-7	*3	*2	-X1
Product Type	W Unit: mm	C Unit: mm	D Unit: mm	Other tin-plate : X1 Other: t

产品尺寸和性能 Product Size And Performance

项目 Items	参数 Parameters
材料 Material	紫铜 Copper
图解 Diagrammatize	
W	7mm±0.2mm
C	3mm±0.2mm
D	2mm±0.1mm
镀层厚度 Coating thickness	≥5μm
使用温度 Operating temperature	65°C ~ 170°C

》 耐久性测试 Endurance Test

项目 Items	极限值 Limits	技术条件 Additional Requirements
焊锡附着性 Solderability	导线至少95%以上新锡覆盖。 Covered with new solder by 95% at least.	焊锡温度: $245\pm5^{\circ}\text{C}$ 。 浸锡时间: 5 ± 0.5 秒。 Test temperature of solder: $245\pm5^{\circ}\text{C}$ Dipping time in solder: $5\pm0.5\text{s}$

》 包装 Packaging

- 散装, 内外双包装 Bulk, Internal And External Package
- 或者编带包装 Or Taping Packaging

》 版本信息 Version History

版本 Version	日期 Date	修正描述 Description of amendment	备注 Remarks
A1.0	21-Sep-2022	First issue	